

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2026-034

联芸科技（杭州）股份有限公司

2026 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

经联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：

1、预计 2026 年半年度实现营业收入 84,969 万元左右，较上年同期（法定披露数据）相比，将增加 23,997 万元左右，同比增加 39%左右。

2、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 51,713 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 46,100 万元左右，同比增加 821%左右。

3、预计 2026 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,410 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,901 万元左右，同比增加 54%左右。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）2025 年半年度营业收入 60,972.15 万元；

（二）2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润 5,613.50 万元；

（三）2025 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,509.34 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务影响

经过多年的发展，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP 设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司紧跟数据中心及 AI PC 发展浪潮，为客户提供覆盖企业级、消费级、嵌入式等主流应用的高能效存储主控芯片产品、平台化的芯片解决方案及全栈技术支持。

1、2026 年上半年，整体存储市场需求保持增长，行业格局持续优化。公司聚焦存储主控主业，把握行业景气机遇，PCIe 3.0、PCIe 4.0、PCIe 5.0 及企业级 SATA 主控芯片等产品持续受益市场扩容，出货量继续保持稳步增长。

2、公司在新产品开发及量产方面取得阶段性进展，存储主控芯片 PCIe 5.0 芯片支持 NVMe 2.1 协议及新一代 LDPC 纠错技术，性能较上一代产品提升近一倍，已在 OEM 厂商端量产；UFS 3.1 主控芯片实现对 QLC NAND 支持，在 NAND 价格上行周期中可有效降低客户整体存储成本；企业级 PCIe 5.0 主控芯片已处于量产测试阶段，相关研发工作有序推进，目前尚未贡献营收，后续量产节奏及业绩贡献存在一定不确定性。此外，公司新一代车载感知信号处理芯片满足 4D 成像毫米波应用要求，适配 L2+及以上高阶辅助驾驶应用，2026 年初完成客户导入，第二季度出货逐步推进。

（二）非经营性损益的影响

2026 年上半年归属于母公司所有者的净利润中预计非经常性损益的金额为 46,303 万元左右，较上年同期大幅增加，主要为公司通过战略配售持有的盛合晶微股份本期确认的公允价值变动收益大幅增加，该事项属于非经常性损益。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断的初步核算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本公告所载 2026 年半年度主要财务数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日